(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年10 月5 日 (05.10.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/104151 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) *C09J 7/02* (2006.01)
C09J 4/02 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/306309

(22) 国際出願日: 2006 年3 月28 日 (28.03.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-095810 2005 年3 月29 日 (29.03.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 古河電気工業株式会社 (THE FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 矢吹朗 (YABUKI, Akira) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 矢野正三 (YANO, Syozo) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 飯田敏三 (IIDA, Toshizo); 〒1050004 東京都港区新橋３丁目１番１０号 石井ビル３階 Tokyo (JP).

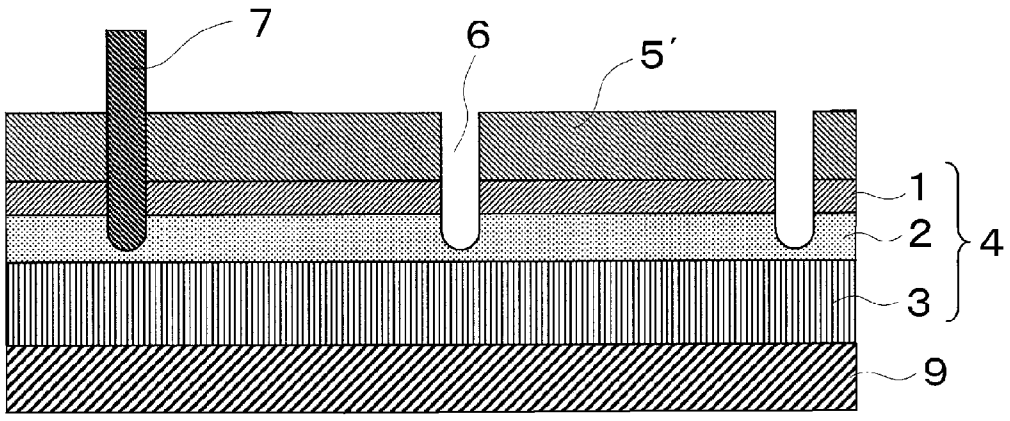
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

[続葉有]

(54) Title: ADHESIVE TAPE FOR WAFER DICING AND CHIP MANUFACTURING METHOD USING SAME

(54) 発明の名称: ウエハダイシング用粘着テープおよびそれを用いたチップの製造方法



(57) Abstract: An adhesive tape for wafer dicing is provided with an adhesive layer on a base material film. The adhesive layer is composed of two or more layers, and a resin composition constituting either adhesive layer includes a radiation polymerization compound. A content of the radiation polymerization compound in the resin composition constituting an outermost layer of the adhesive layer and that in a resin composition constituting the inner side adhesive layer are different to a degree to sufficiently transmit a stress applied on the base material film to the outermost layer after the radiation irradiation to separate the layer from a chip. A chip manufacturing method using such adhesive tape is also provided.

(57) 要約: 基材フィルム上に粘着剤層が設けられたウエハダイシング用粘着テープであって、該粘着剤層は２層以上からなり、いずれの粘着剤層を構成する樹脂組成物も放射線重合性化合物を含有するとともに、粘着剤層の最外層を構成する樹脂組成物における放射線重合性化合物の含有量と内側の粘着剤層を構成する樹脂組成物におけるそれが、基材フィルムに印加した応力が放射線照射後の最外層に十分に伝わり、該層とチップを剥離するに十分な程度に異なるウエハダイシング用粘着テープ、およびそれを用いたチップの製造方法。

WO 2006/104151 A1

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。